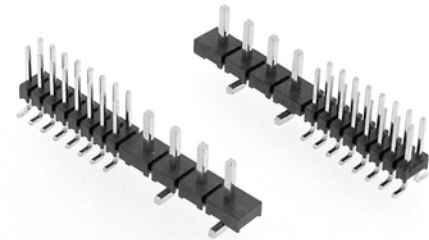


## SMT-Stiftleisten RM 5,08/2,54mm, stehend - Power/Signal-Kontakte SMT Pin Headers, 5.08/2.54mm Pitch, Vertical - Power/Signal Contacts

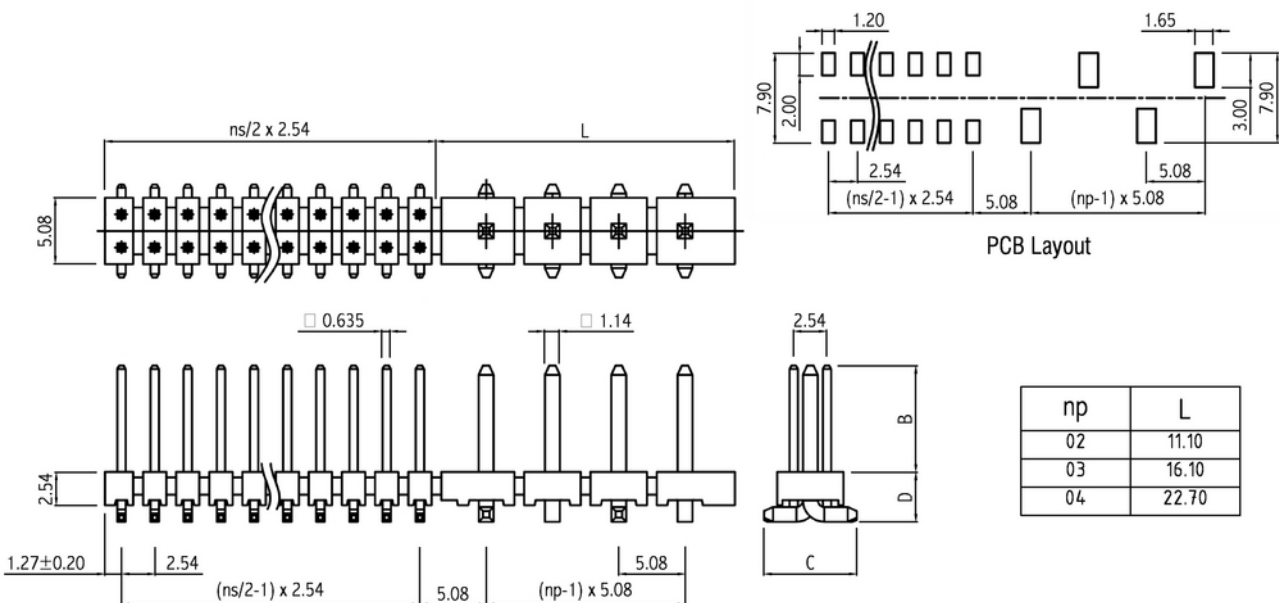
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 1,14mm, Kupferlegierung <i>1.14mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options, over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub> <i>500V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A / 8,2A <i>3A / 8.2A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Mate with Female Headers:  
**397 3970**



Series	Signal Contacts*	Power Contacts*	Dimensions*	Plating*	Packaging*
<b>9870</b>	<b>12</b> 02-24	<b>03</b> 02-04	<b>20</b> 10 B=5.84 C=7.11 D=3.81 20 B=8.13 C=7.11 D=3.81	<b>60</b> 00 Au Flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn	<b>PPST</b> ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen / In tubes  
**PPST** In Stangen mit Pick&Place-Pad / In tubes with Pick&Place Pad  
**PPTR** Tape & Reel / Tape & Reel

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wppro.com  
WEBSITE www.wppro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

